

住友ベークライト株式会社
京セラ株式会社からの半導体関連材料を中心としたケミカル事業の譲受について
主な質疑応答議事録

日時：2026年1月22日（木）16時30分～17時15分

スピーカー：代表取締役社長 鍛治屋 伸一

出席者：代表取締役会長 藤原 一彦、取締役専務執行役員 小林 孝、

取締役専務執行役員 倉知 圭介、取締役常務執行役員 平井 俊也、

執行役員 沖 博美

Q：取引概要・収益貢献の見立て

- 譲受対象事業の売上規模は約232億円（2025年3月期）。
- 当社の認識では、対象事業は現状でも黒字。
- シナジーも含め採算性は十分期待できるとしている。

Q：売上内訳

- 売上の内訳イメージ：半導体材料（封止材・ボンディングペースト等）約7割
工業樹脂/高機能プラスチック等3割弱

Q：競争力の源泉：熱マネジメント（高熱伝導）×先端パッケージ需要

- 高熱伝導・熱マネジメント技術の強化が今後期待しているシナジー。
- AIデータセンター向けの伸長で、プロセッサー/メモリ/パワーデバイスの高性能化
→発熱対策ニーズが増大していく。
- 京セラ側は特にBGA構造や熱伝導材料にフォーカスしており、当社の既存領域と組み合わせて提案範囲を広げ、先端パッケージ（2.5D/3D等）での競争力を高める狙い。

Q：シナジーのタイムライン

- 2026年10月末に予定しているクロージング後に研究・顧客評価が必要で、早くても1年程度かかる見立て。

Q：リスク・懸念事項

- 過去の認証不正について：一時停滞はあったようだが、現在は対策含めクリア、売上も回復していると認識。
- 地域別売上比率（半導体向け）：現時点では非開示。
- 買収価格の妥当性：検討の上で適正価値と判断した。

Q：高機能プラスチック事業（用途とシナジーの方向性）

- 配合技術の融合で自動車用途でのシナジーが期待できる。

Q：資本政策・今後の投資姿勢

- 今回のM&Aは中期計画上大きいが、これで投資が止まるわけではなく、案件探索は継続する姿勢。
- 株主還元は安定的・継続的に行う方針で不变

以上